

eX-tech2026”（エクステック 2026）テーマ参加型展示企画 出展募集のお知らせ

東京ビッグサイト東展示棟で「電子機器トータルソリューション展 2025」と同時開催します当学会主催「2026 マイクロエレクトロニクスショー」の特別イベントとして、たいへん簡易でしかもリーズナブルな価格で広く製品・技術を PR できる展示企画 eX- tech 2025（エクステック 2025）“の出展募集をいたします。

1. 概 要

(1)会 期：2026 年 6 月 10 日（水）～6 月 12 日（金）の 3 日間

(2)会 場：東京ビッグサイト 東展示棟

(3)対象テーマ：「明日のエレクトロニクス産業を支える先端実装技術・製品」とさせていただきます。

具体的な技術分野は以下のとおりです。

実装・電子技術分野全般（プリントブルエレクトロニクス、部品内蔵技術、パワーエレクトロニクス、カーエレクトロニクス、ヘルスケア、材料技術、回路・実装設計技術、高速高周波技術、電磁特性技術、電子部品・実装技術、光回路実装技術、環境調和型実装技術、半導体パッケージ技術、マイクロメカトロニクス実装技術など）、各種関連製造装置

(4)出展資格：（一社）エレクトロニクス実装学会の会員が所属する企業または賛助会員であり（出展申し込みと同時にご入会頂けます）、また出展する内容が上記対象テーマ（3）のいずれかに合致していること。※ **個人名義での出展は不可とします。**

(5)出展料金：80,000 円+消費税／小間

※ パネル、ポスター等の展示物ほかの費用は各出展者のご負担によりご用意願います。展示物のサイズはブース内に展示可能な範囲にて自由です。

(6) 展示ブース仕様

別紙 1 を参照ください。

(7) その他留意事項

①ブース位置は事務局にご一任下さい。

②より効果的な PR を目指す目的で、展示会事業委員会にて審議を行い技術分野毎にゾーニングを行う予定です。例：「プリントブルデバイスゾーン」「部品内蔵技術ゾーン」「パワーエレクトロニクスゾーン」など。

③展示ブースに常駐する説明員は、可能な限り配置下さるようお願い致します。

2.出展申込み

出展申込み方法：別途ホームページに掲載いたします。出展申込み締切り：2026 年 2 月 27 日（金）

3.お問合せ先

(1)展示会・展示会場全般に関するお問合せ

展示会運営事務局

(2)出展申込書の内容に関するお問合せ

エレクトロニクス実装学会 事務局（担当：浪岡/石川）

TEL 03-5310-2010 E-mail：tenji@jiep.or.jp